

以熱燈絲化學氣相沉積法成長多晶矽薄膜結構性質之研究

魏正哲、李世鴻

E-mail: 9509713@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究使用熱燈絲化學氣相沉積法於玻璃基板上沉積多晶矽薄膜，並使用SEM、拉曼光譜、AFM、XRD及XPS來量測其結構性質。實驗顯示，只有當燈絲溫度比1750°C更高時，所沉積的薄膜才會是多晶結構，而且結晶率會隨燈絲溫度的升高而上升，並在1900°C以上時逐漸達到飽和。此外，我們也發現燈絲與基板之間的距離是決定薄膜結晶結構的最關鍵因素。而從XRD的量測與分析，我們也可獲得一致的結果。當燈絲溫度較高且燈絲與基板距離較接近時，所沉積的薄膜呈現多晶的結構，且晶面優選方位為(220)，其結晶率會隨燈絲溫度上升而增加。為了獲得結晶率與結晶顆粒尺寸之間的關係，我們利用AFM量測到結晶顆粒形態、結晶顆粒尺寸及表面粗糙度。實驗顯示，在較高的燈絲溫度狀況下，所沉積薄膜的結晶顆粒尺寸會比較大，而平均表面粗糙度也會增大。這說明結晶顆粒尺寸的增大乃是造成較高燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜會有較高結晶率的主要原因。

關鍵詞：多晶矽；熱燈絲化學氣相沉積

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 誌謝
vi 目錄	vii 圖目錄
x 表目錄	
.xii 第一章 緒論	1 1.1 前言
1 1.2 研究背景	2 1.3 研究動機
.4 第二章 原理	7 2.1 太陽能電池
.7 2.2 太陽光電池的種類	8 2.2.1 單晶矽太陽光電池 8 2.2.2
多晶矽太陽光電池	10 2.2.3 薄膜型太陽光電池 11 2.3 薄膜電晶體液晶顯示器
示器	13 2.3.1 薄膜電晶體 13 2.3.2 TFT 在LCD 上的應用
.15 2.3.3 非晶矽薄膜和多晶矽薄膜	16 2.4 熱燈絲化學氣相沉積法
.17 2.4.1 氣相沉積理論與薄膜製作技術	17 2.4.2 熱燈絲化學氣相沉積技術 19 2.4.3
熱燈絲化學氣相沉積多晶矽薄膜	21 2.4.4 热燈絲化學氣相沉積法之優點 21 第三章 實驗
.23 3.1 擴散幫浦原理	23 3.1 擴散幫浦原理 25 3.2 實驗樣本製作
.25 3.3 實驗準備工作	25 3.3 實驗準備工作 26 3.4 實驗步驟
.27 3.5 實驗參數設計	27 3.5 實驗參數設計 27 3.6 結果分析
.28 3.6.1 薄膜測厚儀量測結果	28 3.6.1 薄膜測厚儀量測結果 28 3.6.2 場發射掃描式電子顯微鏡
.29 3.6.3 原子力顯微鏡	31 3.6.3 原子力顯微鏡 31 3.6.4 三度共焦拉曼顯微鏡 31 3.6.5
X光繞射儀	35 3.6.6 X射線光電子能譜儀 36 第四章 結果與討論
.37 4.1 沉積速率	37 4.1 沉積速率 37 4.2 SEM表面影像
.42 4.3 AFM	42 4.3 AFM 49 4.4 拉曼
.51 4.5 XRD	51 4.5 XRD 57 4.6 XPS
.60 4.7 氢化	60 4.7 氢化 62 4.8 電導率
.65 第五章 結論	65 第五章 結論 67 參考文獻
.69 圖目錄 圖2.1 太陽電池種類圖	69 圖目錄 圖2.1 太陽電池種類圖 8 圖2.2 串聯效率不同之
太陽光電池	9 圖2.3 非晶矽薄膜型太陽光電池之結構圖 12 圖2.4 物理吸附示意圖
附示意圖	18 圖2.5 薄膜成長機制示意圖 18
圖3.1 實驗設備HWCVD	24 圖3.2 HWCVD示意圖
.24 圖3.3 鎢絲型號24 圖3.3 鎢絲型號 27 圖3.4 FE SEM場發射掃描式電子顯微鏡
.30 圖3.5 FESEM場發射掃描式電子顯微鏡示意圖30 圖3.5 FESEM場發射掃描式電子顯微鏡示意圖 30 圖3.6 將拉曼光譜分成非晶、多晶、以及微晶區的示意圖
、以及微晶區的示意圖	33 圖3.7 拉曼示意圖 34 圖3.8 X光繞射儀示意圖
.35 圖4.1 鎢絲溫度與沉積速率的關係35 圖4.1 鎢絲溫度與沉積速率的關係 38 圖4.2 沉積壓

力與沉積速率的關係	39	圖4.3 鎢絲至基板距離與沉積速率的關係	41
圖4.4 以HWCVD沉積多晶矽薄膜的表面FESEM照片	43	圖4.5 多晶矽薄膜在不同溫度下的表面FESEM照片	
. 44		圖4.6多晶矽薄膜在不同溫度下的結晶尺寸圖	45
圖4.6多晶矽薄膜在不同溫度下的結晶尺寸圖	45	圖4.7在不同壓力下所成長的多晶矽薄膜的FESEM照片	
圖4.7在不同壓力下所成長的多晶矽薄膜的FESEM照片		圖4.8多晶矽薄膜在不同壓力下的結晶尺寸圖	47
圖4.8多晶矽薄膜在不同壓力下的結晶尺寸圖	47	圖4.9 以HWCVD沉積非晶矽薄膜的表面FESEM照片	48
圖4.9 以HWCVD沉積非晶矽薄膜的表面FESEM照片	48	圖4.10不同鎢絲溫度所成長多晶矽薄膜之AFM	50
圖4.10不同鎢絲溫度所成長多晶矽薄膜之AFM	50	圖4.11 不同壓力及燈絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的拉曼光譜圖	53
圖4.11 不同壓力及燈絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的拉曼光譜圖	53	圖4.12 不同壓力之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的結晶率	55
圖4.12 不同壓力之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的結晶率	55	圖4.13不同鎢絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的結晶率	56
圖4.13不同鎢絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的結晶率	56	圖4.14 不同壓力及燈絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的XRD圖	59
圖4.14 不同壓力及燈絲至基板距離之狀況下，改變燈絲溫度所沉積多晶矽薄膜的XRD圖	59	圖4.15不同鎢絲與基板的距離所成長多晶矽薄膜之XRD圖	60
圖4.15不同鎢絲與基板的距離所成長多晶矽薄膜之XRD圖	60	圖4.16 以HWCVD成長多晶矽薄膜之XPS圖	61
圖4.16 以HWCVD成長多晶矽薄膜之XPS圖	61	圖4.17以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經過氫化處理前後之薄膜厚度	
圖4.17以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經過氫化處理前後之薄膜厚度		圖4.18以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經氫化處理後之拉曼光譜圖	63
圖4.18以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經氫化處理後之拉曼光譜圖	63	圖4.19以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經氫化處理後之結晶率	64
圖4.19以HWCVD所沉積的多晶矽薄膜，經氫化處理後之結晶率	64	表目錄 表1.1 世界各地太陽能平均年日照量	65
表目錄 表1.1 世界各地太陽能平均年日照量	65	表3.1 玻璃清洗流程	6
表3.1 玻璃清洗流程	6	表3.2 HWCVD沉積實驗之標準參數	26
表3.2 HWCVD沉積實驗之標準參數	26	表4.1多晶矽薄膜在不同鎢絲溫度的厚度與電導率	28
表4.1多晶矽薄膜在不同鎢絲溫度的厚度與電導率	28	表4.2多晶矽薄膜經氫化處理後在不同鎢絲溫度的厚度與電導率	66
表4.2多晶矽薄膜經氫化處理後在不同鎢絲溫度的厚度與電導率	66		

參考文獻

- [1] Benner, J., P., (1999). Photovoltaics gaining greater visibility. IEEE spectrum, 36, 34-42.
- [2] Carlson, D., E., (1995). Resent Advances in Photovoltaics. Proceedings of the Intersociety Engineering Conference on Energy Conversion.
- [3] Choi, M., P., Tan, A., (1998). Photovoltaics Demonstration Projects Proceedings of Energy Management and Power Delivery, 2, 637-643.
- [4] Mark Fitzgerald (2002), PV History. from <http://www.pvpower.com/pvphome.html>.
- [5] 黃信雄(1997)。因應「氣候變化綱要公約」的我國太陽能應用策略。太陽能學刊第二卷。第一期。
- [6] 黃秉鈞(1997)。我國太陽能發展的現況與展望。光訊。第六十八期。
- [7] 黃秉鈞(1996)。我國太陽光電能的過去與未來。太陽能學刊第二卷。第一期。
- [8] 唐宗賓(2001)。市電並聯型光伏系統之研製。國立清華大學碩士論文。
- [9] 黃崇傑(2002)。太陽電池的製作技術。太陽光電發電系統技術研討會。
- [10] 莊嘉琛(1997)。太陽能工程-太陽電池篇。全華圖書。
- [11] 廠商所提供之1998 Siemens Solar Industries.
- [12] 劉文漢(2002)。中壢地區全天候即時太陽光電能發電之監測分析。私立中原大學碩士論文。
- [13] 吳財福、張健軒、陳裕愷(2000)。太陽能供電與照明系統綜論。全華圖書。
- [14] Gobind, H., Atmaram, Christy Herig, (1990). First Year performance of a 15kWp Amorphous Silicon Photovoltaic System. IEEE Transactions on Energy Conversion, 5, 290-298.
- [15] Dimitrios, N. K., Apostolos, T. V., & Miltiadis, K, Hatalis, (1996). High-Performance Thin-Film Transistor in Large Grain Size Polysilicon Deposited by Thermal Decomposition of Disilane. IEEE Transactions on Electron Devices, 43, 9.
- [16] 羅吉宗(2004)。薄膜科技與應用。全華科技圖書出版。
- [17] 莊達人(2001)。VLSI製程技術。高立圖書出版。
- [18] 王陽元、趙寶瑛(2001)。多晶矽薄膜及其在集成電路中的應用。科學出版社。
- [19] Sze, S., M., (1988). VLSI Technology, Pearson Prentice Hall Companies.
- [20] CMolenbroek, E., Ph.D. Thesis, (1995). University of Colorado.
- [21] Matsumura, H., Umemoto H., & Masuda, A., (2004). Cat-CVD(hot-wire): how different from PECVD in preparing amorphous silicon. Journal of Non-Crystalline Solids, 338, 19-26.
- [22] Matsumura, H., Umemoto, H., Izumi, A., & Masuda, A., Recent (2001). Progres of Cat-CVD research in Japan—bridging between the first and second Cat-CVD conferences. Thin Solid Films, 430, 7-14.
- [23] Masuda, A., Izumi, A., Umemoto, H., Matsumura H., & Masuda, A., (2002). What is the difference between catalytic CVD and plasma-enhanced CVD. Vacuum, 66, 293-297.
- [24] Uchida, K., Izumi, A., & Matsumura, H., (2001). Novel chamber cleaning method using atomic hydrogen generated by hot catalyzer. Thin Solid Films, 395, 75-77.
- [25] Loseen, J., Klein, S., & Finger, F. (2004). Optimization of the filament arrangement at constant radiant heat in HW-CVD for thepreparation of compact μ c-Si:H at high deposition rates. Thin Solid Films, 451-452, 531-535.
- [26] Inoue, K., Tange, S., Tonokure K., & Koshi, M., (2001). Catalytic decomposition of SiH₄ on a hot filament. 395, 42-46.

- [27] Heintze, M., Carapella, J., Nelson, B. P., & Crandall, R. S. (1991). Deposition of device quality, low H content amprphous silicon. *Journal of Applied Physics*, 69, 6728-6730.
- [28] Molenbroek, E. C. (1995). Ph.D. Thesis, University of Colorado.